

Dynarex[®]

全氟橡膠O型圈

TM

本系列產品在高溫環境下展現出卓越的物理特性，在正常操作條件下，其連續使用溫度可超過 325° C，並具備更優異的抗壓縮變形能力。本產品適用於擴散製程（Diffusion）、離子佈植退火製程（Implant Anneal）、快速熱製程（RTP）以及各類管件與閥件等應用，最高連續使用溫度可達 325° C。

物理特性

- ◆ 優良的耐電漿性
- ◆ 極低重量變化率
- ◆ 高潔淨度低產塵

建議應用位置

- ◆ 擴散製程
- ◆ 佈植退火製程
- ◆ 快速熱製程

極低微粒

傳統 FFKM 密封材料透過添加硫酸鋇或二氧化鈦等無機填充劑來抵抗電漿侵蝕，雖然能有效保護聚合物並降低減重，但蝕刻後殘留的顆粒極易造成微粒污染；相較之下，無填充或高分子填充的新型配方僅含碳、氟、氧等元素。



物性表		TM-W	TM-B
顏色		白色	黑色
最高工作溫度		325°C	325°C
物理測試	硬度 (JIS-A)	71	70
	拉伸強度 (Mpa)	14.5	15.0
	延伸率 (%)	150	160
	100% 拉伸應力 (Mpa)	5.8	6.0
耐熱測試	測試條件	300°C × 70hr	300°C × 70hr
	壓縮變形率 (%)	32	30